

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成19年9月27日(2007.9.27)

【公開番号】特開2005-335397(P2005-335397A)

【公開日】平成17年12月8日(2005.12.8)

【年通号数】公開・登録公報2005-048

【出願番号】特願2005-208110(P2005-208110)

【国際特許分類】

B 32B 27/36 (2006.01)

【F I】

B 32B 27/36 102

【手続補正書】

【提出日】平成19年8月10日(2007.8.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリカーボネート系樹脂の基材層、その少なくとも片面に押出、共押出、又は押出コーティングにより積層した、ポリカーボネート系樹脂と5～50重量%のカーボンブラックとの表面層からなり、該表面層の表面固有抵抗値が 10^2 ～ 10^{10} であるシート。

【請求項2】

240 × 10kg荷重でのMFIが2.6g/10分以上ある導電性樹脂組成物の表面層からなる請求項1に記載のシート。

【請求項3】

基材層のポリカーボネート系樹脂の粘度平均分子量が25000以上ある請求項1または請求項2のシート。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載のシートからなる電子部品用包装容器。